证券简称: 奥特维

无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者	✓ 特定对象调研	□分析师会议	□媒体采访	✓业绩说明会	
关系活 动类别	□新闻发布会	□路演活动	□现场参观	✓电话会议	
参与单 位名称	易方达基金、南方: 林基金、华商基金:				
, , , ,	机构及证券公司	· 70.70-1 - 10.70		<u> </u>	711 100 71-005
时间	2025 年 10 月				
地点	公司会议室				
上市公					
司接待	董事会秘书周永秀:	女士、财务总监殷	哲先生、锂电公	司总经理张波先生、	、证券部李翠芬、
人员姓	陶敏燕、张秋仪、	零子健			

Q: 多分片技术是否会对现有的串焊机设备产生影响? 现有设备能通过改造应用多分片工

艺?A: 多分片技术对钝化、激光等方面的工艺要求较高,因多分片工艺较为复杂,预计现有串焊机设备进行多分片工艺改造的难度较大。

Q: 现阶段公司的改造业务进展情况如何? 如何评估改造业务对公司整体业绩的影响?

A: 受光伏行业下行影响,客户对现有设备改造的需求量逐步增加,公司改造业务在订单中的占比持续提升。因设备改造业务的毛利率略高于设备毛利率,且收入确认时间也比设备确认收入时间短,若未来设备改造订单持续增长将对公司整体业绩产生积极影响。

Q: 公司储能业务和固态电池设备有什么进展?

A: 储能业务方面,公司当前核心客户为系统集成商与电芯制造商。伴随储能需求增长及电芯工艺迭代,市场对电芯设备及系统集成装备的需求持续提升,受益于行业需求回升,公司储能设备订单持续增长。固态电池方面,公司与行业知名客户合作进行硫化物固态电池设备的研发,部分设备已发往客户端。

Q: 公司在锂电设备领域的竞争优势是什么?

A: 公司锂电设备的竞争优势有两点: 1. 底层技术: 锂电设备的核心底层技术为激光技术、精密运动控制技术等,与公司的核心技术能力高度契合,具备技术竞争力; 2. 集成能力: 锂电设备主要依赖集成能力,公司通过多年积累形成的较强集成能力,结合公司底层技术,在产品端拥有较强的竞争力。

Q: 公司半导体领域的设备主要有哪些?目前的进展如何?

A: 现阶段公司半导体领域的设备主要为(1)封测端: 划片机、装片机、铝线键合机、AOI 检测设备;(2)光模块的 AOI 检测设备;(3) CMP 设备。受益于半导体封测产业链的回暖带 来的需求增加,公司铝线键合机和 AOI 设备已收获批量订单。公司的光模块 AOI 检测设备在收获海外批量订单后,已发往国内客户端进行验证。CMP 设备由公司日本子公司负责研发,目前研发按计划推进。2025 年公司半导体设备订单持续增长,截至三季度末订单金额已创历史新高。

Q: 公司光模块 AOI 设备的竞争优势是什么?

A: 在推出光模块 AOI 检测设备前,公司已拥有半导体封测端 AOI 设备技术储备,相关技术可迁移至光模块检测环节并适配客户需求。在设备工艺方面,公司与客户保持紧密沟通,可快速针对客户的需求改进工艺。此外,由于公司的光模块 AOI 检测设备已实现海外批量出货且在国内客户端验证,在市场竞争中拥有较强的先发优势。

日期 2025年10月31日